課題管理番号：

令和　年　　月　　日

封　　印　　申　　請　　書

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　殿

（代表者又は知的財産権の譲渡等の権限を有する者）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究機関名 | ： |  |
| 所属 役職 | ： |  |
| 氏名 | ： |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名／プログラム名 |  |
| 研究開発課題名 |  |
| 研究開発担当者所属 役職 氏名 |  |

委託研究開発契約書第１１条第 ● 項の規定により、下記のとおり封印を行うことを申請します。

記

１．封印事項

　　　　　　年　　月　　日付委託研究開発契約の締結時における、当該契約の研究開発課題「研究開発課題名」、「分担研究開発課題名（該当する場合のみ）」に係る当社所有の技術情報

２．封印の実施

　　　　　　　　　　　社　　　　　　　　　を代理人として封印を行う。

３．封印後の保管

　　封印文書は、成果報告書を日本医療研究開発機構が受領するまで　　　　　　社において責任を持って保管する。その後は　　　　　　社が必要に応じて処分を行うこととする。

　添付する文書

　　(1) 封印するもののリスト 別紙　１（参照）

　　(2) 封印実施者への委任状 別紙　２（参照）

　　備　考：用紙の寸法は日本工業規格Ａ列４とし、左とじとすること。

別　紙　１

　（封印リスト）

　　研究開発課題「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　分担研究開発課題「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管 理 番 号 | 　　技術情報の名称　　　　 | 　　関連資料の名称又は番号等 |
| １００１ |  ××△△の製造条件 | 　　８８５４（スペック） |
| １００２ |  ○×○○の製造法 | 　　○○技報第１８５号 |
| １００３ |  ○△×△の製造法 | 　　８８５４７２Ａ（図面） |
| １００４ |  （品　番） | 　　（図面及び半導体集積回路） |
|  |  |  |
| １００１Ａ |  ○×○×の製造方法 | 　　特許出願準備中 |
|  |  | ８８５４７３Ｂ図面××○○データ |
|  |  | 　　 |
|  |  |  |

　（注）出願準備中のものは関連資料の封印も行う。

|  |  |
| --- | --- |
|  課題管理番号 |  ○○○○○○○○○ |

　　備　考：用紙の寸法は日本工業規格Ａ列４とし、左とじとすること。

別　紙　２

令和　年　月　日

委　　　　任　　　　状

国立研究開発法人　日本医療研究開発機構　殿

（契約者又は知的財産権の譲渡等の権限を有する者）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究機関名 | ： |  |
| 所属 役職 | ： |  |
| 氏名 | ： |  |

　　令和　年　　月　　日付け委託研究開発契約に基づく研究開発課題「　研究開発課題名　」、「分担研究開発課題名（該当する場合のみ）」の締結時における当社所有の当該開発に係る技術情報の封印に関し（氏　名）を代理人と定め、下記のとおり権限を委任する。

記

１．権　限　　上記封印に関する一切の権限

２．受任者 役職名、氏名及び使用印鑑

|  |  |
| --- | --- |
|  課題管理番号 |  ○○○○○○○○○ |

　　備　考：用紙の寸法は日本工業規格Ａ列４とし、左とじとすること。